

合肥颀中科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研☐分析师会议 ☐媒体采访☒业绩说明会 ☐新闻发布会☐路演/反路演活动 ☐现场参加☒电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	中邮证券、中银证券、UBS Securities、大成基金、华安证券、东北证券、西南证券、华金证券、国信证券、天风证券、长城证券、兴业证券等
时间	2025 年 4 月 1 日
上市公司接待人员姓名	总经理：杨宗铭 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强
投资者关系活动主要内容介绍	1. 问：公司 OLED 的客户有哪些？ 答：目前主要有瑞鼎、云英谷、集创北方、联咏、昇显微、芯颖、奕斯伟、禹创等客户。 2. 问：2025 年度合肥厂的产能规划是什么？ 答：首阶段产能规划为 BP 与 CP 各约 2 万片/月产能，COF 约 3,000 万颗/月产能，COG 约 3,000 万颗/月产能，该预计不构成对投资者的承诺。 3. 问：境内和境外客户结构的占比？ 答：2024 年，公司内销收入占比约 63%，外销收入占比约 37%。 4. 问：铜镍金凸块应用非显示驱动芯片和显示驱动芯片的优势？ 答：铜镍金凸块是对传统引线键合（Wire bonding）封装方式的优化方案。具体而言，铜镍金凸块可以通过大幅增加芯片表面凸块的面积，在不改变芯片内部原有线路结构的基础之上，对原有芯片进行重新布线（RDL），大大提高了引线键合的灵活性。此外，铜镍金凸块中铜的占比相对较高，因而具有天然的成本优势。由于电源管理芯片需要具备高可靠、高电流等特性，且常常需要在高温的环境下使用，而铜镍金凸块可以满足上述要求并大幅降低导通电阻，因此铜镍金凸块目前主要应用于电

	源管理类芯片。 显示驱动芯片方面，因对性能要求高，主要使用金凸块，但是金材料带来了高成本，铜镍金凸块制造技术不断突破创新，公司扩展了铜镍金凸块在显示驱动芯片的应用，实现了高精度、高可靠性、微细间距的技术水平，同时大幅降低了材料成本。 5. 问：公司产品的终端应用占比如何？ 答：由于公司仅为客户提供封装测试服务，客户不会明确告知所封测芯片的终端应用情况，因此公司结合产品指标、下游客户收入结构等特性，分析所封测芯片的主要终端应用领域情况。分析结论为：截至 2024 年，显示业务方面，高清电视占比约 35%，智能手机占比约 50%，笔记本电脑接近 6%；非显示业务方面，电源管理占比约 60%，射频前端占比超 30%。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 2 日